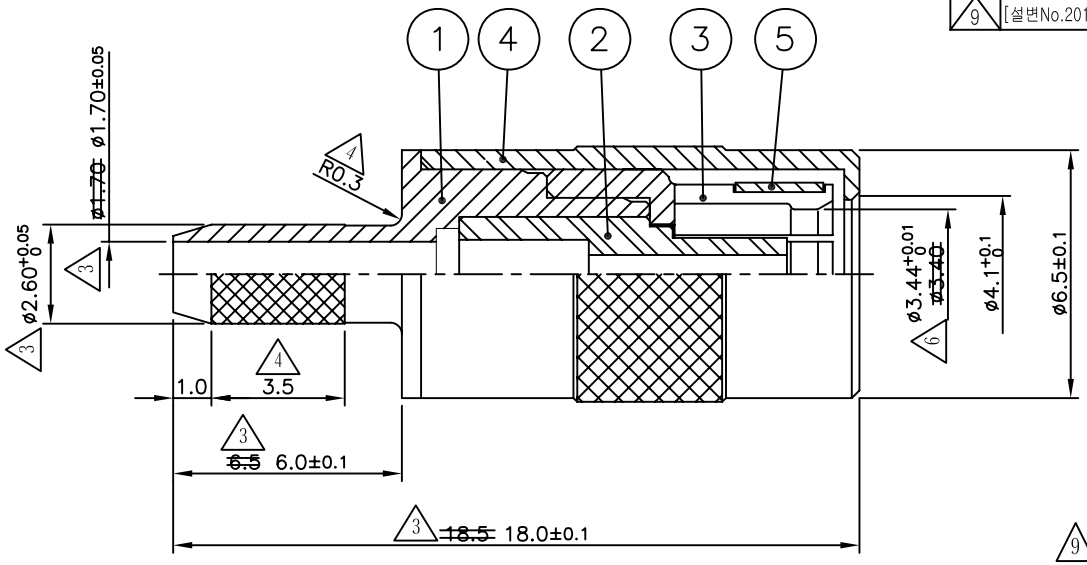
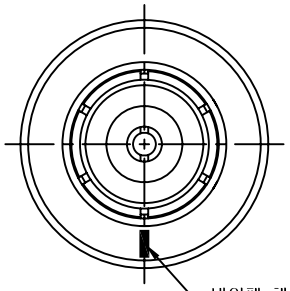
REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	Y.H.SON	J.B.KIL	2004.06.21.
1	[설변No.연구2005-001] 도금 두께 변경	Y.H.SON	J.B.KIL	2005.01.12.
2	[설변No.연구2005-104] 신뢰성 향상	I.C.KIM	I.H.YU	2005.05.03.
3	[설변No.연구2005-149] 도면 표준화 작업 (널링부 변경)	C.L.CHOI	I.H.YU	2005.06.14.
4	[설변No.연구2005-211] 업체요구 (널링 부위 간격 표준화, 라운드 추가)	E.H.KIM	C.L.CHOI	2005.09.05.
5	[설변No.200906-0001] 업체요구 (FERRULE 삭제)	E.H.KIM	S.J.YOUN	2009.06.01.
6	[설변No.201001-0014] 표준화 (조립도 및 부품도 치수 오기 변경)	I.C.KIM	Y.H.CHOI	2010.01.18.
7	[설변No.201204-0003] 기타 (쇼트방지 홈 추가)	I.C.KIM	J.H.YOUN	2012.04.10.
8	[설변No.201311-0005] 업체요구 (CONTACT 구성 삭제)	E.H.KIM	I.C.KIM	2013.11.14.
9	[설변No.201507-0025] BeCu C17300에서 BeCu C17200으로 재질 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.07.24.





네임펜 체크 (한신)

	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE
9	5	SPRING RING	1	BeCu C17200	Copper Plate	DSR00009-5/1
2 1	4	CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5㎛	DCU00033-5/1
3 2 1	3	JACK	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5㎛	DJA00028-5/1
	2	INSULATOR	1	PTFE		DIN00339-N/1
5	~~3~~	~~FERRULE~~	~~1~~	~~MBsBD C3604BD-F~~	~~Nickel Plate 2~3㎛~~	~~DFE00034-5/1~~
8 1	~~2~~	~~CONTACT~~	~~1~~	~~MBsBD C3604BD-F~~	~~Gold Plate 0.4㎛~~	~~DCT00348-5/1~~
7 2 1	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5㎛	DBD00484-5/1

주 기

1. 상대물과의 삽입력과 이탈력 (상대물과 Mating 5회 이후 측정치)
   - 삽입력 : 2~4Kgf
   - 이탈력 : 5~8Kgf
2. 상대물 Jack 외경 ø3.64~3.67이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
3. 도금 사양 (1)
   내장용(실내)
   - Nickel Plate : 5㎛ 이상 (BODY, JACK, CAP)
   - Gold Plate : 0.4㎛ 이상 (CONTACT)

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE	2015. 07. 24.
	Angle ±1°	APPROVED BY	I.C.KIM
		CHECKED BY	S.M.LEE
MATERIAL	-	DRAWN BY	H.J.LEE
FINISH	-	SCALE 5/1	UNIT mm

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

TITLE SMB50 CABLE PS RG316 (SMB S/T FEMALE)

A4 | DWG NO. CN00187-7/1 | REVISION 9 | SHEET 1 of 1